課題番号 :F-13-NU-0074

利用形態:機器利用

利用課題名(日本語) :セラミック薄膜の X 線回折測定

Program Title (English) :X-ray diffraction measurement of ceramic film

利用者名(日本語) :三ツロ 真司, <u>世古 尚嗣</u> Username (English) :S. Mitsuguchi, <u>N. Seko</u>

所属名(日本語) : CKD 株式会社 Affiliation (English) : CKD Corporation

1. 概要(Summary)

MEMS デバイスに必要な窒化ケイ素薄膜について、成膜条件の違いによる組成比の違いを、X 線回折法を用いて確認する。

4. その他・特記事項 (Others)

なし。

5. 論文・学会発表 (Publication/Presentation) なし。

2. 実験 (Experimental)

測定装置···薄膜 X 線回折装置 (RIGAKU 社製 ATX-G)

6. 関連特許 (Patent)

なし。

3. 結果と考察(Results and Discussion)

成膜時のガス流量、圧力等を変えたサンプルに対し、窒化ケイ素のピークが最も強く出る2 θ =35°付近を測定比較したが、どのサンプルも Fig.1 と同様のピークとなり、顕著な差が見られなかった。

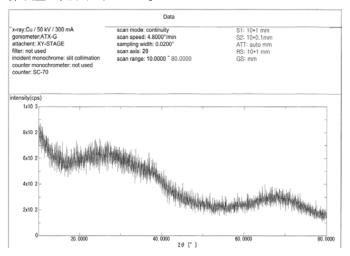


Fig.1 XRD pattern of silicon nitride film

窒化ケイ素薄膜の組成比を分析する方法について、今 後も調査を継続していく予定である。